



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

| 【 1. 適用範囲 SC |
|--------------|
|--------------|

| 本仕様書は、 | | 殿 | に納入する |
|--------|---------------------------------------|---|-------|
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

<u>O.5 mm ピッチ 基板対基板用 コネクタ</u> について規定する。 This specification covers the 0.5 mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR series.

【 2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 】

| 製品名称 Product Name | 製 品 型 番 Part Number | |
|---|------------------------|------------|
| リセプタクル ハウジング アッセンブリ Receptacle Housing Assembly | 無 鉛 LEAD FREE | 54102-***1 |
| 5 4 1 0 2 ー * * * 1 エンボス梱包品 Embossed tape Package For 54102-***1 | 無 鉛 LEAD FREE | 54102-***8 |
| プラグ アッセンブリ Plug Assembly | 無 鉛 LEAD FREE | 53885-***1 |
| 5 3 8 8 5 ー * * * 1 エンボス梱包品 Embossed tape Package For 53885-***1 | 無 鉛 LEAD FREE | 53885-***8 |

^{*:} 図面参照 Refer to the drawing.

【 3. 定 格 RATINGS 】

| 項 目 Item | 規 格 Standard | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| 最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.) | 50 V | 「AC(実効値 rms)/ DC] | | |
| 最大許容電流 Rated Current (MAX.) | 0.5 A | 「AC(美刈胆 IIIIS)/ DC] | | |
| 使用温度範囲 Ambient Temperature Range | -40°C ~ +85°C ¹ | | | |

*1:通電による温度上昇分も含む。

Including terminal temperature rise.

| | REV. | В | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|-------|------|------------------|----------|---|--|------------|----|--------------|--------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|-----|
| | SHEET | 1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVI | SE OI | N PC | ONL | <u> </u> | | TITLE | : | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変 | 更 | | | 0.5mm BOARD TO BOARD CONNECTOR | | | | | | | | | | | | |
| | В | | | REVI | SED | | | | | | | (H | gt = 2 | 2.5mr | n) | | | | | |
| | ם | J2004-3970 | | | -LEAD FREE- 製品仕村 | | | | | 様書 | | | | | | | | | | |
| | '04/04/23 J.SAS | | | SASA | AMOR | RI | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO | | | | | | то | | | | | | | |
| | REV. | | DE | SCR | PTIC | N | | MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION | | | | | | | | | | | | |
| | DESIG | GN C | ONTF | ROL | S | TATU | JS | | ΓΤΕΝ Y: | CH | HECKE BY: | D | APPRO BY | | I | DATE | : YR/N | /IO/D/ | ΑY | |
| | J | | | _ | T. AMORI | k | CTOJC |) | M.SA | • | | 20 | 04/04 | 1/23 | | | | | | |
| DOCUMENT NUMBER | | | | | | | | | | | F | ILE N | AME | , | SHEE | T | | | | |
| PS-54102-001 | | | | | | | | | | | PS | 541020 | 001.doc | | 1 OF | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | FN | J-37(C | 119 |





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【 4. 性 能 PERFORMANCE 】

<u>4-1. 電気的性能 Electrical Performance</u>

| | 項 目 Item | 条 件 Test Condition | 規 格 Requirement |
|-------|-------------------------------------|--|------------------------|
| 4-1-1 | 接触抵抗 Contact Resistance | コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA. (JIS C5402 5.4) | 40 milliohm MAX. |
| 4-1-2 | 絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance | コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302) | 100 Megohm MIN. |
| 4-1-3 | 耐 電 圧 Dielectric Strength | コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC(rms) 500V (実効値) を 1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 500V AC (rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301) | 異状なきこと No Breakdown |

<u>4-2. 機械的性能 Mechanical Performance</u>

| | 項 目 Item | 条 件 Test Condition | 規 格 Requirement |
|-------|---|--|-------------------------------|
| 4-2-1 | 挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force | 毎分 25±3mm の速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute. | 第6項参照 Refer to paragraph 6 |
| 4-2-2 | ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force | ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm/minute on the terminal assembled in the housing. | 0.49N { 0.05 kgf } MIN. |

| | | REVISE ON PC ONLY | TITLE: | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--|--|--|
| | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD CONNECTOR (Hgt = 2.5mm) -LEAD FREE- 製品仕様書 | | | | | |
| | REV. | DESCRIPTION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION | | | | | |
| DOC | CUMENT I | NUMBER | | FILE NAME | SHEET | | | |
| PS-54102-001 | | | | PS54102001.doc | 2 OF 8 | | | |
| | | | | EN- | 37-1(019) | | | |





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

| | 項 目 Item | 条 件 Test Condition | 規 Re | 格 quirement |
|-------|--|--|-------------------------------|---------------------|
| 4-3-1 | 繰返し挿抜 Repeated Insertion / Withdrawal | 1分間 10回 以下の速さで挿入、抜去を 30回 繰返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute. | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |
| 4-3-2 | 温度上昇 Temperature Rise | コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電 し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498) | 温度上昇 Temperature Rise | 30 °C MAX. |
| | | DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 3方向 に掃引割合 10~55~10 Hz/ 分 全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加え | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage |
| 4-3-3 | 耐 振 動 性 Vibration | る。 (MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time : 10~55~10 Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X.Y.Z. axes (MIL-STD-202 Method 201) | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |
| | | | 瞬 断 Discontinuity | 1.0 microsec. MAX. |
| | 耐 衝 撃 性 Shock | | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage |
| 4-3-4 | | | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |
| | | axes. (JIS C0041/MIL-STD-202 Method 213) | | 1.0 microsec. MAX. |
| 4-3-5 | 耐 熱 性 Heat Resistance | | | 異状なきこと No Damage |
| 4-3-5 | | | | 80 milliohm MAX. |

| | | REVISE ON PC ONLY | TITLE: | | | | |
|-----|---------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|--|--|
| | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD CONNECTOR (Hgt = 2.5mm) -LEAD FREE- 製品仕様書 | | | | |
| | REV. | DESCRIPTION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT | | | | |
| DOC | TMENT 1 | NUMBER S-54102-001 | | FILE NAME PS54102001.doc | SHEET 3 OF 8 | | |
| | | | L | EN- | 37-1(019) | | |





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

| | 項 目 Item | 条 件 Test Condition | 規 Re | 格 quirement |
|-------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 4-3-6 | 耐寒性 | コネクタを嵌合させ、-25±3℃ の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放 置する。 | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage |
| | Cold Resistance | (JIS C0020) -25±3°C, 96 hours (JIS C0020) | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |
| | | コネクタを嵌合させ、40±2°C 、相対湿度 90 | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage |
| 4-3-7 | 耐湿性 | ~95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0022/MIL-STD-202 試験法 103) | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |
| 4-3-7 | Humidity | Temperature : 40±2°C Relative Humidity : 90~95% Duration : 96 hours | 耐 電 圧 Dielectric Strength | 4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3 |
| | | (JIS C0022/MIL-STD-202 Method 103) | 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 100 Megohm MIN. |
| 4.3.8 | 温度サイクル Temperature Cycling | コネクタを嵌合させ、-55℃ に 30分、+85℃ に 30分 これを 1サイクル とし、5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後 1~2時間 室温に放置する。 | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage |
| 4-3-8 | | (110 00005) | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |
| 4-3-9 | 塩 水 噴 霧 Salt Spray | コネクタを嵌合させ、35±2°C にて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage |
| 4-3-9 | | (JIS C0023/MIL-STD-202 試験法 101) 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2°C. (JIS C0023/MIL-STD-202 Method 101) | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. |

| | | REVISE ON PC ONLY | TITLE: | | | | | |
|----|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--|--|--|
| | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD CONNECTOR (Hgt = 2.5mm) -LEAD FREE- 製品仕様書 | | | | | |
| | REV. | DESCRIPTION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION | | | | | |
| DO | CUMENT I | | | FILE NAME | SHEET | | | |
| | P | S-54102-001 | | PS54102001.doc | 4 OF 8 | | | |
| | | | | EN- | 37-1(019) | | | |





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

| 項 目 Item | | 条 件 Test Condition | 規 格 Requirement | | |
|-------------|--|--|-------------------------------|---|--|
| 4-3-10 | 亜硫酸ガス SO ₂ Gas | コ ネ ク タ を 嵌 合 さ せ 、 40±2℃ に て 50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間 放置す る。 | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage | |
| | | 24 hours exposure to 50±5ppm. SO ₂ gas at 40±2°C. | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. | |
| 4-3-11 | 耐アンモニア性 | コネクタを嵌合させ、濃度 28% のアンモニア水を入れた容器中に 40分間 放置する。 (1L に対して 25ml の割合 | 外 観 Appearance | 異状なきこと No Damage | |
| 4011 | NH₃ Gas | 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution. | 接触抵抗 Contact Resistance | 80 milliohm MAX. | |
| 4-3-12 | 半田付け性 Solderability | 端子先端より 0.3mm、金具先端より 0.3mm の位置まで、245±3°C の半田に 3±0.5秒 浸す。 Soldering Time : 3±0.5 seconds. Solder Temperature: 245±3°C 0.3mm from terminal tip 0.3mm from fitting nail tip | 濡れ性 Solder Wetting | 浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes. | |
| | | (リフロー時) 第7項の条件にて、2回 リフローを行う。 (When reflowing) Repeat paragraph 7, condition two times. | | | |
| 4-3-13 | 半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat | (手半田) 端子先端より 0.3mm、金具先端より 0.3mm の位置まで 370~400℃ の半田ゴテにて 最 大5秒 加熱する。 (Soldering iron method) Soldering time : 5 sec. MAX. Solder Temperature: 370~400℃ 0.3mm from terminal tip 0.3mm from fitting nail tip | 外 観 Appearance | 端子ガタ、割れ等 異状なきこと No Damage | |

():参考規格 Reference Standard { }:参考単位 Reference Unit

| | REVISE ON PC ONLY | | TITLE: | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|
| | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD (Hgt = 2.5mm -LEAD FREE- | n) | 仕様書 |
| | REV. | DESCRIPTION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSI | | |
| DOCUMENT NUMBER PS-54102-001 | | | | FILE NAME PS54102001.doc | SHEET 5 OF 8 |
| | | | 1 | EN- | 37-1(019) |





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【 5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS 】 図面参照 Refer to the drawing.

【 6. 挿入力及び抜去力 INSERTION/WITHDRAWAL FORCE 】

| 極 数 | 単位 | | 入力(最大値 nsertion (MAX | • | | 去力(最小値 ithdrawal (MI | • |
|--------|-------|-------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|
| No. of | UNIT | 初回 | 6 回目 | 3 O 回目 | 初回 | 6 回目 | 3 O 回目 |
| CKT | | 1st | 6th | 30th | 1st | 6th | 30th |
| 20 | N | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 6.86 | 4.90 | 4.90 |
| | {kgf} | {5.0} | {5.0} | {5.0} | {0.70} | {0.50} | {0.50} |
| 30 | N | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 6.86 | 4.90 | 4.90 |
| | {kgf} | {5.0} | {5.0} | {5.0} | {0.70} | {0.50} | {0.50} |
| 40 | N | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 6.86 | 4.90 | 4.90 |
| | {kgf} | {5.0} | {5.0} | {5.0} | {0.70} | {0.50} | {0.50} |
| 50 | N | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 6.86 | 4.90 | 4.90 |
| | {kgf} | {5.0} | {5.0} | {5.0} | {0.70} | {0.50} | {0.50} |
| 60 | N | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 6.86 | 4.90 | 4.90 |
| | {kgf} | {5.0} | {5.0} | {5.0} | {0.70} | {0.50} | {0.50} |
| 70 | N | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 6.86 | 4.90 | 4.90 |
| | {kgf} | {5.0} | {5.0} | {5.0} | {0.70} | {0.50} | {0.50} |

| | | REVISE ON PC ONLY | | TITLE: | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|
| | | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD (Hgt = 2.5mm -LEAD FREE | n) | 仕様書 |
| | | REV. | DESCRIPTION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION | | |
| | DOCUMENT NUMBER PS-54102-001 | | | | FILE NAME PS54102001.doc | SHEET 6 OF 8 |
| | | | | | | 37-1(019) |

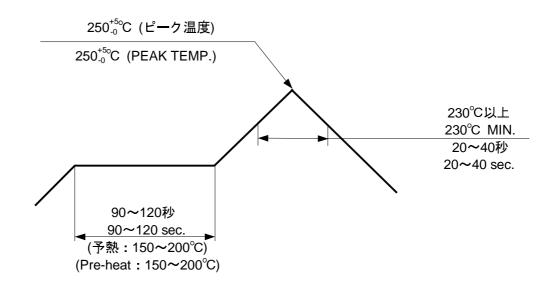




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【 7. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION 】



<u>温度条件グラフ</u> (温度は基板パターン面)

TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記; 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、

事前にリフロー評価の確認をお願い致します。

NOTE; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.

| | | REVISE ON PC ONLY | | TITLE: | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|
| | | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD (Hgt = 2.5mm -LEAD FREE | n) | 仕様書 |
| | | REV. | DESCRIPTION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT | | _ |
| | DOCUMENT NUMBER PS-54102-001 | | | | FILE NAME PS54102001.doc | SHEET 7 OF 8 |
| | | | | | | 37-1(019) |





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

| REV. | REV. RECORD | DATE | EC NO. | WRITTEN BY : | CHECKED BY: |
|------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| А | RELEASED | '04/04/23 | J2004-3970 | J.SASAMORI | K.TOJO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | REVISE ON PC ONLY | | TITLE: | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--|------------------|-----------|--|
| | В | SEE SHEET 1 OF 8 | 0.5mm BOARD TO BOARD (Hgt = 2.5mm -LEAD FREE- | n) | 仕様書 | |
| | DE) / | DECODIDEION | THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION | | | |
| | REV. | DESCRIPTION | WOLLX INC. AND SHOOLD NOT BE USED WIT | HOUT WRITTEN FER | IVIIOSION | |
| DOCUMENT NUMBER | | | | FILE NAME | SHEET | |
| PS-54102-001 | | | | PS54102001.doc | 8 OF 8 | |
| | | | | EN- | 37-1(019) | |